

第三代半导体工作简报

2018 年第 1 期 总第 26 期

主办：第三代半导体产业技术创新战略联盟 2017 年 3 月 30 日

导 读

- 中关村顺义园管委会组织召开第三代半导体产业规划与专项扶持政策论证会
- 第三代半导体联盟举办军民融合研讨会
- 第三代半导体联盟标委会召开第一届第二次管理委员会会议

中关村顺义园管委会组织召开第三代半导体产业规划与 专项扶持政策论证会

为加快顺义区第三代半导体产业发展，推动相关企业和项目落地，2018年1月24日，中关村顺义园管委会组织召开了第三代半导体产业规划和专项扶持政策论证会。



中国科学院半导体研究所原所长、973项目首席科学家李晋闽教授，北京大学物理学院副院长沈波教授，第三代半导体产业技术创新战略联盟吴玲理事长，中关村管委会、市科委及市经信委、中关村顺义园相关领导，中国电子科技集团公司第十三研究所等重点企业负责人参与研讨。

第三代半导体产业技术创新战略联盟秘书长于坤山汇报了顺义区第三代半导体产业规划；中关村顺义园管委会产业发展处、规划建设处处长王政权汇报了顺义区专项扶持政策。与会专家、相关领导、企业代表就产业规划和专项政策的编制完善提出了具体指导

意见。

讨论认为，产业规划和专项政策的编制完善既要突出第三代半导体产业链不同环节的特点，又要有不同于国内其他已布局第三代半导体产业地区的特色。在突出北京特色、顺义特色、产业特色上达成一致，即突出“北京建设全国科技创新中心”这一主题，强化北京科研机构以及人才众多、央企资源丰富、第三代半导体研发基础雄厚的北京特色，依托中关村，凸显顺义区作为“一区”建设主平台的作用，发挥顺义区以雄厚产业基础带动产业转型升级的势能优势。

下一步，中关村顺义园将认真归纳汇总本次论证会的指导意见，尽快形成较完善的顺义区第三代半导体产业规划和专项扶持政策。

第三代半导体军民融合研讨会在京举办

为了促进第三代半导体行业军民融合的进一步发展，由第三代半导体产业技术创新战略联盟军民融合委员会于 2018 年 3 月 8 日在京组织召开了第三代半导体军民融合研讨会。来自北京大学、北京工业大学、中山大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、电子科技大学、天津理工大学、中科院半导体所、中电科十三所、中电科五十五所、三安集团有限公司、北京卫星制造厂有限公司等 15 家单位 30 人参加了此次会议。会议由第三代半导体产业技术创新战略联盟秘书长于坤山主持。



联盟副秘书长赵璐冰博士作了《联盟参与 2030 国家重点新材料研发与应用重大项目汇报》；联盟军民融合委员会副主任万成安作了《第三代半导体在航天领域的应用现状及前景》汇报；中电科五十五研究员所黄润华博士作了《SiC 技术最新进展》汇报；中山大学和亮博士做了《GaN 技术最新进展》的报告。北京卫星制造厂

副总经理韩建超介绍了单位概况和前期开展工作情况。

听取报告后，联盟理事长吴玲女士对如何加深合作，推进国内第三代半导体器件的宇航应用和军民融合等工作提出明确要求。



第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长 吴玲

与会代表也都发表了自己的看法和建议。大家一致认为，推进第三代半导体产业发展和加快军民融合都是国家的战略部署。第三代半导体技术对军工技术有非常大的支撑作用。通过本次研讨，联盟军民融合委员会将对会议提出的主要问题进行全面梳理，加快第三代半导体军民融合的进度，增进第三代半导体军民融合的深度，明确任务接口及相关要求，同步开展第三代半导体器件宇航应用的推进工作，在重大专项立项前做好技术储备和支撑工作。

第三代半导体联盟标委会召开第一届第二次管理委员会会议

2018年3月23日,第三代半导体产业技术创新战略联盟(CASA)标准化委员会管理委员会第一届第二次会议在西安顺利召开,(CASA)标准化委员会管理委员会委员及标准起草小组成员共35人参加了本次会议。会议由CASA秘书长、标委会常务副主任于坤山主持。



CASA 标准化委员会秘书处高伟博士汇报了标委会 2017 年开展的工作,并对 2018 年标委会的重点工作进行了梳理。工作组召集人、中国科学院微电子研究所许恒宇副研究员汇报了第三代半导体器件检测工作组工作进展及《碳化硅肖特基势垒二极管测试方法》标准的进展情况;工作组召集人、西安特锐德智能充电科技有限公司李建华高级经理汇报了电动汽车充电设施标准工作组工作进展及《SiC 器件在 DC/DC 充电模块应用技术报告》的进展情况。

与会委员就 SiC 器件应用现状及前景、器件应用面临的问题、标准体系化建设、新标准的发起和启动、标委会的组织与协调等问

题展开了热烈的讨论，并就东莞中镓半导体科技有限公司牵头起草的《宽禁带半导体术语》，东莞天域半导体有限公司牵头起草的《p-IGBT 器件用 4H 碳化硅(4H-SiC)外延晶片》、《4H 碳化硅(4H-SiC)晶体及外延层缺陷》等三项标准提案进行了讨论。下午，与会专家参观了西安特锐德智能充电科技有限公司。



参观西安特锐德智能充电科技有限公司

未来，标委会将加速提升联盟团体标准的快速反应能力，及时反映市场需求，为支撑产业健康、快速发展做出贡献。

主办：第三代半导体产业技术创新战略联盟

电话：010-82388680

传真：010-82388580

地址：北京市海淀区清华东路甲 35 号（中科院半导体所院内 5 号楼 5 层）

邮编：100083